

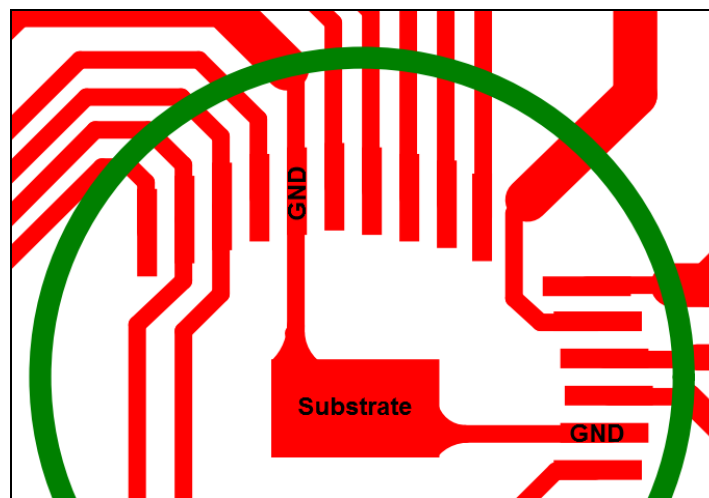
语音 IC 的 PCB Layout 注意事项

内容：说明语音 IC 在播放过程中会产生高热，如果 COB 散热不良，有机会超过工作温度范围，请客户留意 PCB layout 的设计。

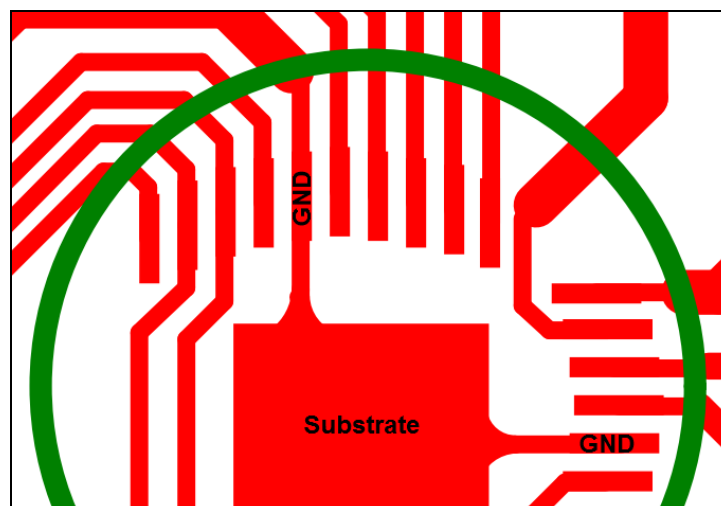
原因：当 IC 播放声音时，会产生高热，电压越高或喇叭欧姆数越低，温度越高，而 PCB 设计不良会导致散热困难，有机会超过工作温度范围。另外，若在未封胶的环境下播放声音，IC 少了黑胶帮助散热，温度会快速提高。

方法：

1. Layout 时，将 COB 的 substrate 与 GND 连接，增加散热面积。



2. Layout 时，将 COB 的 substrate 加大，增加散热面积。



3. COB 封胶帮助散热。